

网版印刷的刮刀压力 及来回推墨的压力分布量测及分析

下面将简单的介绍如何在 PCB 制程当中，利用电子量测的方式
量测锡膏模板印刷和网板印刷之刮印刀压力分布

I-Scan 系统为您提供了一个能够评估、观察，并平衡刮印刀施力的必要工具。此系统利用一个将薄型(0.004 吋)的网格化电子感测电路，印刷于薄型聚酯基材上的 I-Scan 超薄感测片，来感测压力分布。将感测片置于网版之下(图 1)并以刮刀刮过其表面，系统的硬件便能够接收到模拟的压力讯号，并将其转为 8-bit 之数字讯号由计算机显示(图 2 和图 3)。

所量测到的压力数据经由计算机屏幕显示，其中包括 2-D (图 2) 和 3-D (图 3) 的压力分布情形。下面挑选 2 个具有代表性的压力分布位置，并将其数据绘制成压力曲线如图 4 所显示。

此系统可成为一套仪器装配工具，用于量测与设定刮印刀的压力分布情形。同时它也可以找出并分析印刷制程中，刮印刀来回移动所产生的压力峰值及其位置。



图 1. I-Scan 感测片置于刮印刀之下

